



2016年3月期

決算説明会

2016年5月25日

 **ワイエイシー株式会社**

(証券コード: 6298)

<http://www.yac.co.jp>

Contents

- 1. ご挨拶、決算の総括**
..... 代表取締役社長 百瀬 武文
- 2. 2016年3月期連結決算の概要**
..... 取締役 管理本部長 寺本 和政
- 3. 2017年3月期連結事業計画**
..... 代表取締役社長 百瀬 武文
- 4. ワイエイシイグループのコア技術のご紹介**
..... 取締役経営戦略本部長 副島 幸雄
- 5. 質疑応答**



1. ご挨拶、決算の総括

..... 代表取締役社長 百瀬 武文

1 決算の総括



- 売上・受注は過去最高
 - ・3つのセグメントがそれぞれ売上を伸ばし、売上高は過去最高を記録
 - ・営業利益は微増も、為替等の影響により、経常利益・当期純利益は縮小
- ディ스플레이関連
 - 大型及び中小型パネル用加熱装置が牽引
 - 一部案件が利益を圧迫
- メカトロニクス関連
 - 半導体、電力会社向け制御機器が好調
- クリーニングその他関連
 - 顧客需要を取り込み、堅調に推移



2. 2016年3月期連結決算の概要

..... 取締役 管理本部長 寺本 和政

2-1 事業結果



売上高前年比1.5倍。為替等の影響により経常利益・当期純利益が縮小。(単位:百万円)

	2015年3月期	2016年3月期	前年同期比 増減額	前年同期比 増減率(%)
売上高	16,622	25,545	8,922	53.7%
営業利益 (営業利益率)	787 (4.7%)	807 (3.2%)	20	2.6%
経常利益	966	546	△420	△43.5%
親会社株主に帰属する 当期純利益	639	28	△611	△95.6%
1株当たり 当期純利益(円)	71.72	3.14	—	—
研究開発費	301	328	26	8.9%
設備投資額	59	147	87	147.1%
減価償却実施額	329	450	120	36.6%

2-2 事業別売上金額

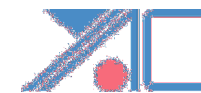


大型及び中小型パネル用加熱装置、電力会社向け制御機器、テストハンドラーが好調。
 当期M&Aのワイエイシイガーターが売上に寄与。

(単位:百万円)

	2015年3月期	2016年3月期	前年同期比 増減額	前年同期比 増減率(%)
ディスプレイ関連	8,795	14,174	5,378	61.1%
		大型及び中小型パネル用加熱装置が好調		
メカトロニクス関連	6,419	9,702	3,282	51.1%
		電力会社向け制御機器、テストハンドラーが好調		
		ワイエイシイガーターが売上に寄与		
クリーニングその他関連	1,407	1,668	261	18.6%
合計	16,622	25,545	8,922	53.7%

2-3 事業別受注金額



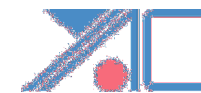
各セグメントとも受注は好調。全体で前年比約2.6倍。
前年比ディスプレイは約4.4倍、メカトロニクスは倍増。

(単位:百万円)

	2015年3月期	2016年3月期	前年同期比 増減額	前年同期比 増減率(%)
ディスプレイ関連	4,305	18,996	14,690	341.2%
メカトロニクス関連	6,971	13,812	6,841	98.1%
クリーニングその他関連	1,939	2,531	592	30.5%
合計	13,215	35,339	22,123	167.4%

2-4 事業別受注残高

※内示含む



(単位:百万円)

前年度を凌駕する大きな受注残を確保。

	2015年3月期	2016年3月期	前年同期比 増減額	前年同期比 増減率(%)
ディスプレイ関連	12,192	11,597	△594	△4.9%
メカトロニクス関連	3,204	5,336	2,131	66.5%
クリーニングその他関連	321	502	181	56.5%
合計	15,718	17,436	1,718	10.9%

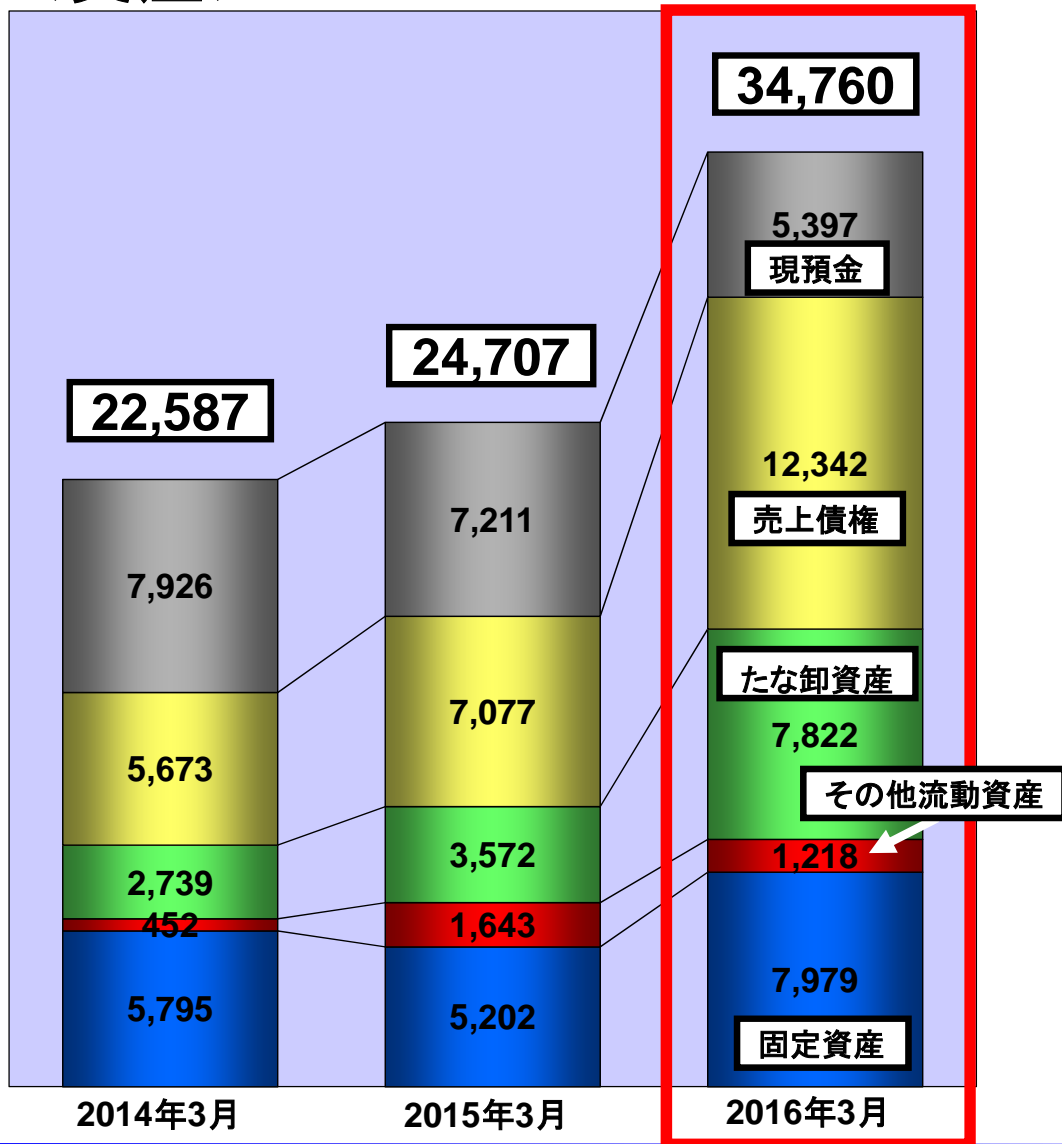
2-5 貸借対照表のレビュー



売上が期末に集中し売上債権が増加。大きな受注残により仕入債務も増加。
ワイエイシイガーターの連結により総資産が増加。

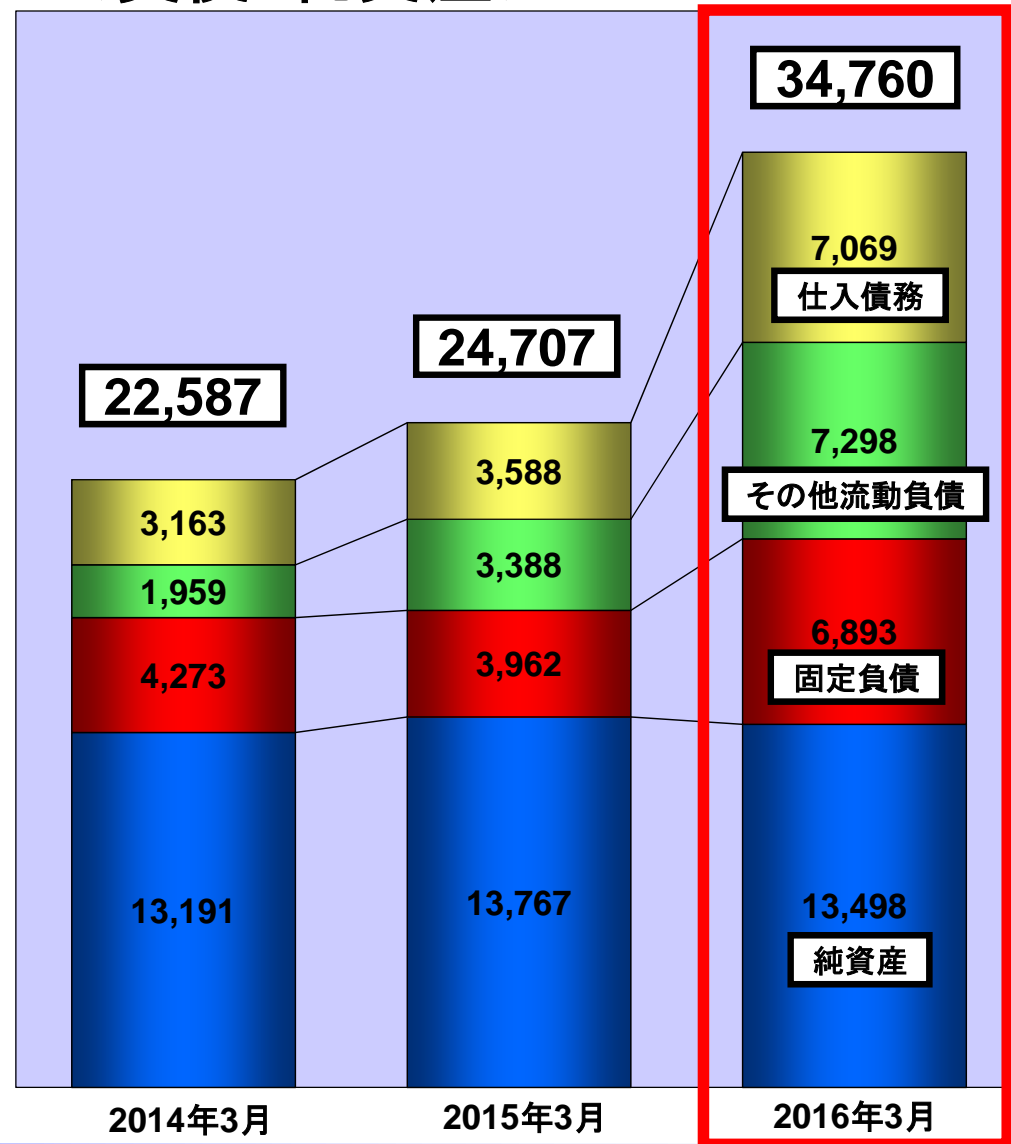
<資産>

(単位:百万円)

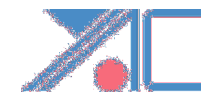


<負債・純資産>

(単位:百万円)



2-6 キャッシュフローのレビュー



期末売上債権の増加等を主な要因とする営業C/Fの減少。
M & Aに伴うC/Fの変化。

(単位:百万円)

	2014年3月期	2015年3月期	2016年3月期
営業活動によるCF	△527	△1,106	△4,715 1~3月の売上債権の大幅増加
投資活動によるCF	△379	△686	△3,862 ワイエイシイガーターの株式取得及び貸付
財務活動によるCF	△177	△502	5,857 M&A実施時の借入金
現金及び現金同等物の 期末残高	7,806	7,966	5,155



3. 2017年3月期連結事業計画

…………… 代表取締役社長 百瀬 武文

3-1-1 事業環境と重点施策



《ディスプレイ関連事業》

事業環境	重点施策
FPD需要の拡大	ドライエッチング・ウエットエッチング、アニール装置のシナジー効果。
新パネル向け需要の拡大	スマホ用の高精細パネル向け、4K・8K TV向けの新パネルに合わせた事業展開。
	有機EL及びフレキシブルパネルへの対応。
低価格化の進行	競争力を高めるコストダウンの実行。

3-1-2 事業環境と重点施策



《メカトロニクス関連事業》

事業	事業環境	重点施策
半導体	自動車のEV化・自動制御の進展	パワー半導体業界(自動車)の設備投資需要の取込。
メカトロニクス	HDDの高密度化の進展	次世代高密度化対応HDD向け設備投資の取込。
	地球環境問題への関心の高まり	新規投入した環境関連新商品の拡販。
太陽電池	太陽電池パネルの高性能化	高効率太陽電池対応のプロセス展開と拡販。
工業計器・制御通信	電力自由化等で設備投資が再開	再生エネルギー及び発送電分離に向けた設備更新の取込。

3-1-3 事業環境と重点施策



《クリーニングその他関連事業》

事業	事業環境	重点施策
クリーニング	国内需要は成熟化	シェア拡大の為の新機種投入、エリア戦略を実施。
	新興国の需要の高まり	アジアを中心に北米、欧州にも販売領域を拡大。
	訪日外国人の増加	リネン関連事業の拡大によるインバウンド需要の取込。
自動車向け金型加熱	金型加熱のガスから電気炉への置き換え	自動車・航空機部品市場の顧客要求に対応した省エネ、高生産性対応装置を供給。

3-2 2016年度見通し



■ 売上 : 300億円
■ 営業利益 : 15億円

- ◎客先の設備投資動向は依然として旺盛
- ◎2015年度受注残170億円
- ◎2015年度下期よりグループ化の
ワイエイシイガーターが2016年度は
通期で業績に寄与

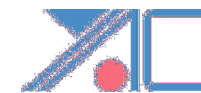
3-3 2017年3月期事業計画



(単位:百万円)

	2014年 3月期 (実績)	2015年 3月期 (実績)	2016年 3月期 (実績)	2017年 3月期 (見込)		前年比 増減額 (見込)	前年比 増減率 (見込)
				上期	通期		
売上高	14,527	16,622	25,545	13,000	30,000	4,454	17.4%
営業利益	427	787	807	400	1,500	692	85.7%
経常利益	546	966	546	350	1,350	803	147.0%
当期純利益	2,229	639	28	230	890	861	3075.1%
1株当たり 当期純利益(円)	250.00	71.72	3.14	25.76	99.68	—	—

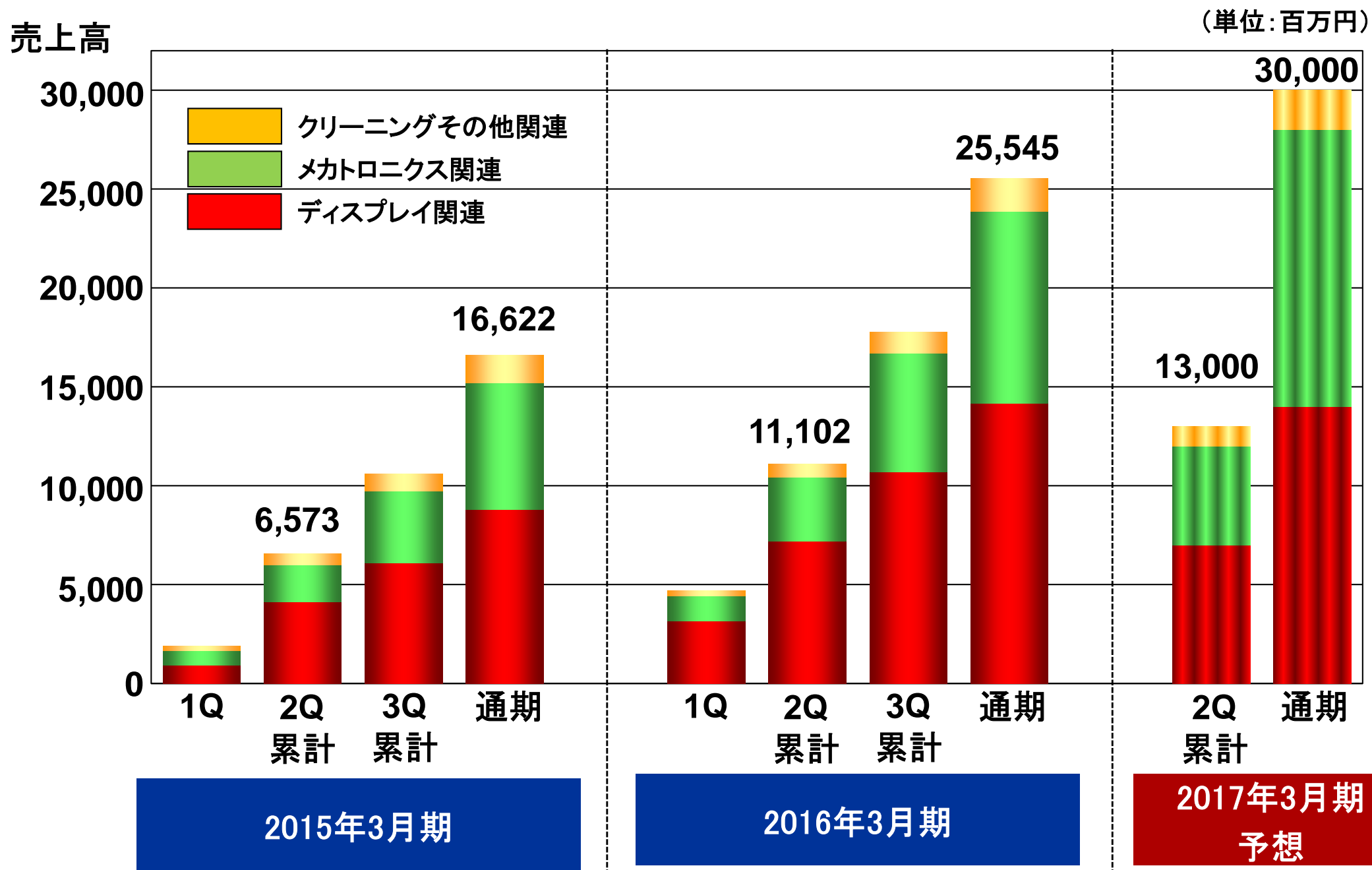
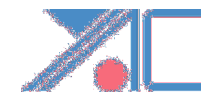
3-4 事業別売上計画



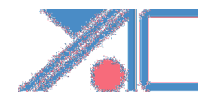
(単位:百万円)

	2016年 3月期 (実績)	2017年 3月期 期首 受注残	2017年3月期(見込)		前年比 増減額 (見込)	前年比 増減率 (見込)
			上期	通期		
ディスプレイ関連事業	14,174	11,597	7,000	14,000	△174	△1.2%
メカトロニクス関連事業	9,702	5,336	5,000	14,000	4,297	44.3%
クリーニングその他 関連事業	1,668	502	1,000	2,000	331	19.8%
合計	25,545	17,436	13,000	30,000	4,454	17.4%

3-5 四半期毎売上高推移

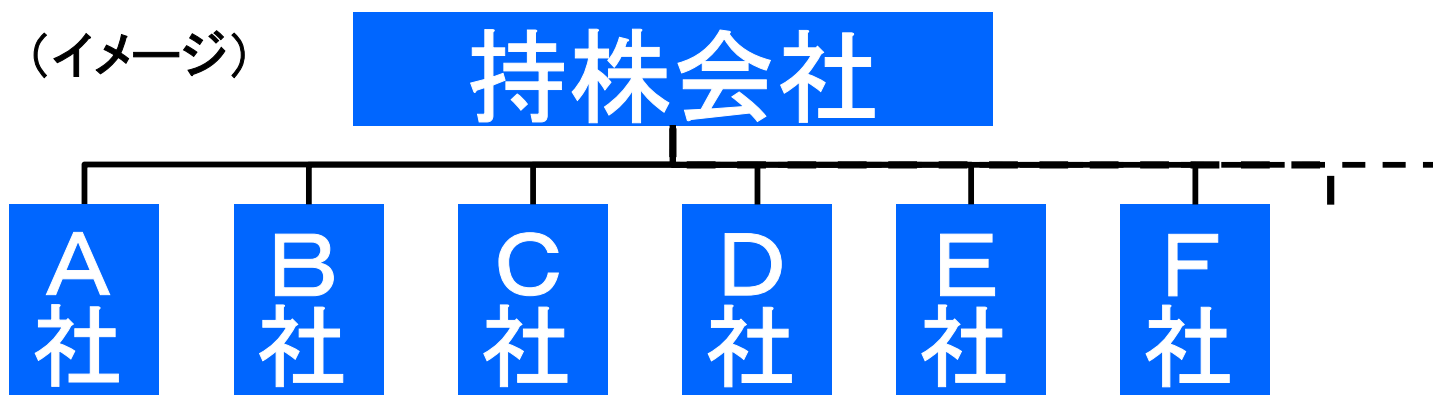


3-7 持株会社体制への移行の検討



グループ経営を高度化させ、競争力、収益力を高め、積極的なM&Aによる規模の拡大を図るため、平成29年4月から持株会社体制に移行する方向で検討を開始いたしました。

具体的な内容につきましては、今後検討を進め、決定次第お知らせいたします。

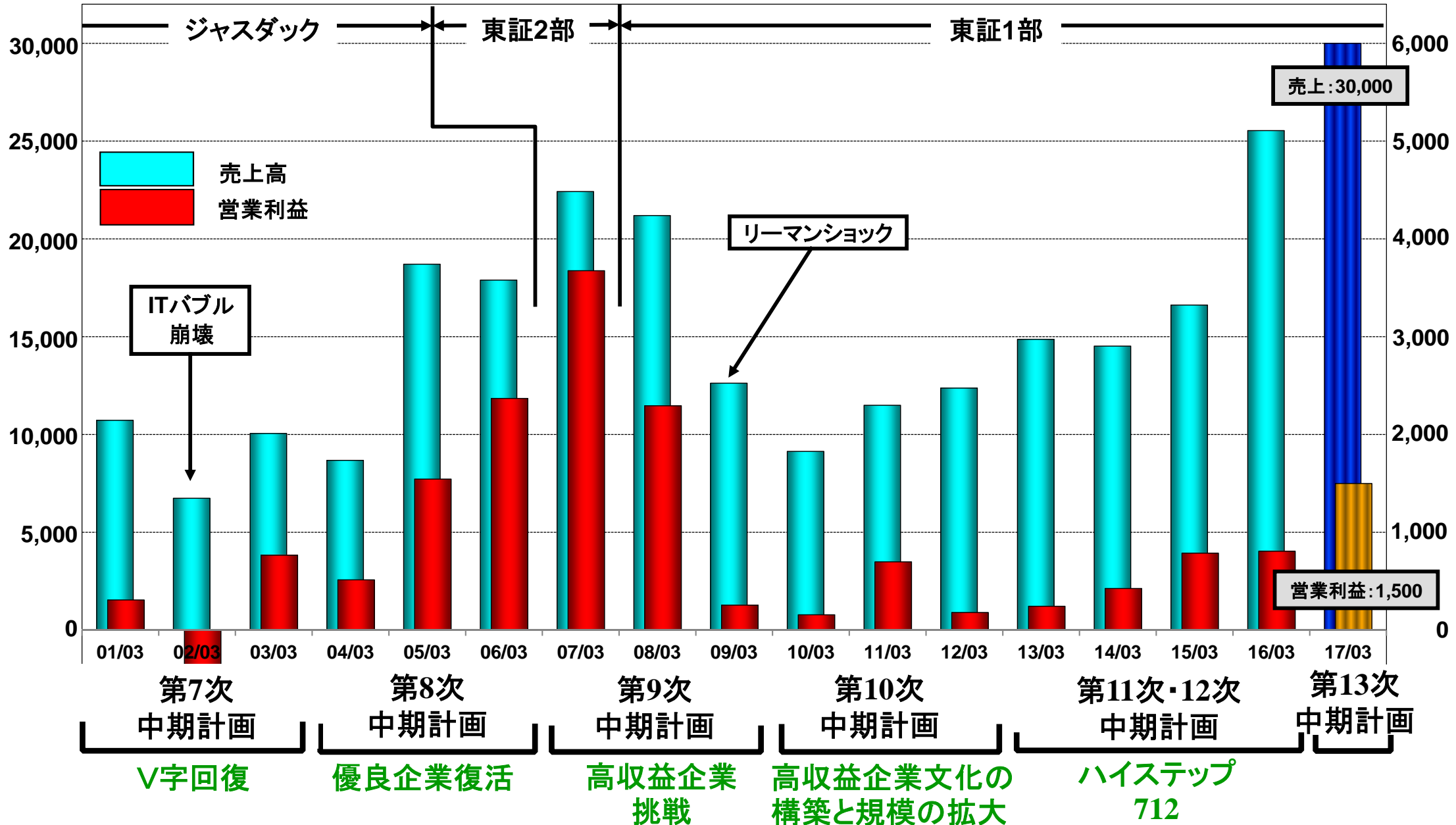


3-8 過去の業績と2017年3月期見込



売上高

(単位:百万円) 営業利益





4. ワイエイシイグループのコア技術のご紹介

・・・ 取締役 経営戦略本部長 副島 幸雄

有機ELディスプレイと当社グループの関わり



有機ELディスプレイが視野角広さ、低消費電力に加え、革新的となる折り畳み式ディスプレイが実現できるデバイスとして次世代スマートフォンへの採用が見込まれています。当社では2000年から長年に渡り、有機ELディスプレイの製造用プロセス装置を出荷しており、現在のラインナップはドライエッチング、ウエットエッチングとアニーリング、ベーキングです。

今後は、折り畳みデバイス向けのフレキシブル有機ELが多くなり、当社の更に高度な熱処理やエッチング技術が必要とされます。低消費電力化のための低周波数駆動のハイブリット回路(LTPO・LTPS)は酸化物半導体の熱処理が追加され、高精細化のために重要な蒸着用マスク形成等には精密なエッチング技術が追加されます。



ドライエッチャー



ウエットエッチャー



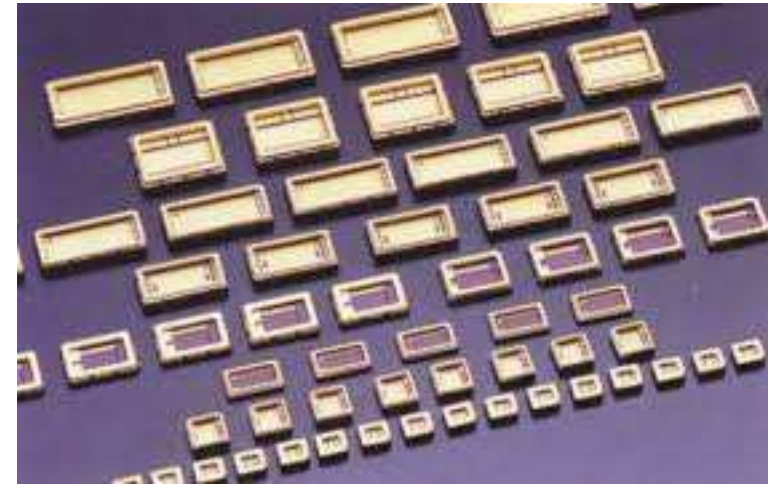
アニール

当社の技術は有機ELディスプレイの製造プロセスを全力で応援していきます。

多層セラミックパッケージ切断装置



IoTデバイス、スマートホン、タブレット等によるインターネットのデータ量が急増しており、無線通信基地局では大幅な通信容量アップが進んでいます。この高速大容量データ通信には、水晶デバイス、SAWフィルタ、高周波デバイスといった小さな電子デバイスを組み込んだ多層セラミックパッケージが使われております。



出典：日本セラミックス協会セラミックス博物館

多層セラミックパッケージは、高温焼結された板厚5ミリ程度の硬いアルミナセラミックを当社のDAS110型切断機を用いて切断して製造されています。DAS110型切断機の特徴は、高剛性筐体に高出カスピンドルを搭載し、薄いブレードで超硬厚板セラミック材料の切断に対応した特徴を備えています。特にセラミックパッケージの熱収縮による寸法歪みに対応した特殊自動アライメント機能等を専用ソフトウェアにより制御した高い生産性を、多くのお客様にご利用頂いております。



DAS110型切断機

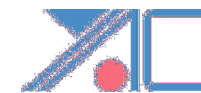
当社は、自動車、医療、パワー半導体に広がっていくセラミックパッケージ製造を切断技術で支えていきます。



添付資料 ワイエイシイの概要

1. 基本情報
2. ワイエイシイの特徴
3. グローバルネットワーク
4. ワイエイシイグループの構成
5. 主力製品

1 基本情報



商号	ワイエイシイ株式会社
証券コード	6298 (東証1部)
設立	1973年(昭和48年)年5月
代表者	代表取締役社長 百瀬武文
事業所等	本社：東京都昭島市武蔵野3-11-10 営業所：大阪、昭島、茨城 工場：昭島、山梨、熊本、大分
グループ会社	株式会社ワイエイシイデンコー (東京都青梅市) 大倉電気株式会社 (埼玉県坂戸市) ワイエイシイ新潟精機株式会社 (新潟県妙高市) 株式会社ワイエイシイダステック (埼玉県戸田市) YAC国際電熱株式会社 (東京都昭島市) ワイエイシイガーター株式会社 (東京都青梅市) YAC Systems Singapore Pte Ltd (シンガポール) 瓦愛新(上海)国際貿易有限公司 (中国上海市) 紹興微愛新電子設備有限公司 (中国紹興市) 台湾微艾新科技股份有限公司 (台湾新竹市)
資本金	2,756百万円
事業内容	ディスプレイ関連装置、メカトロニクス関連装置、 クリーニング関連装置の開発・設計・製造・販売
決算	3月31日

2 ワイエイシイの特徴



- 前期新たに1社を加えて 多岐に渡る事業領域
- ファブレス
- M & A(過去15年間で12社の実績)
- アジアに注力した製・販のグローバル展開
- 全員参加型経営(大討論会)

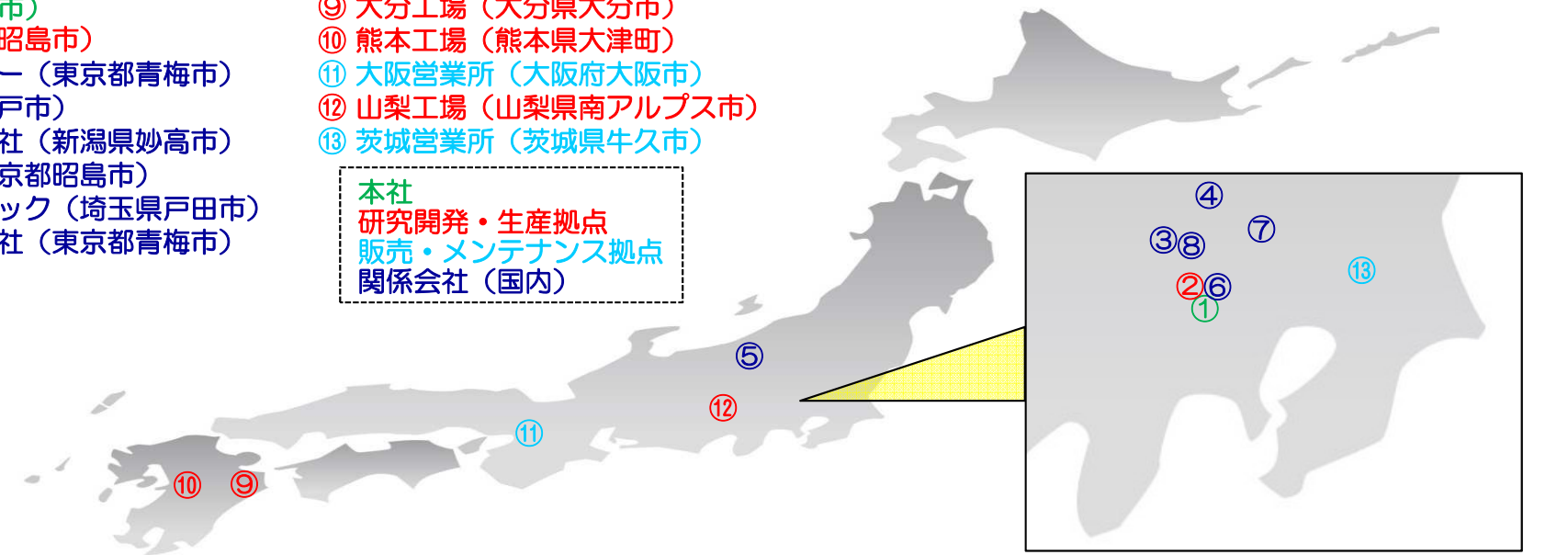
3 グローバルネットワーク



- ① 本社・本社工場（東京都昭島市）
- ② テクニカルセンター（東京都昭島市）
- ③ 株式会社ワイエイシイデンコー（東京都青梅市）
- ④ 大倉電気株式会社（埼玉県坂戸市）
- ⑤ ワイエイシイ新潟精機株式会社（新潟県妙高市）
- ⑥ YAC国際電熱株式会社（東京都昭島市）
- ⑦ 株式会社ワイエイシイダステック（埼玉県戸田市）
- ⑧ ワイエイシイガーター株式会社（東京都青梅市）

- ⑨ 大分工場（大分県大分市）
- ⑩ 熊本工場（熊本県大津町）
- ⑪ 大阪営業所（大阪府大阪市）
- ⑫ 山梨工場（山梨県南アルプス市）
- ⑬ 茨城営業所（茨城県牛久市）

本社
研究開発・生産拠点
販売・メンテナンス拠点
関係会社（国内）



- A) YAC Systems Singapore Pte Ltd（シンガポール）
- B) 瓦愛新（上海）国際貿易有限公司（中国上海市）
- C) 紹興微愛新電子設備有限公司（中国紹興市）
- D) 台湾微艾新科技股份有限公司（台湾新竹市）
- E) NIHON GARTER PHILIPPINES, INC.
- F) 蘇州嘉大電子有限公司（中国）
- G) NGC Garter (M) Sdn. Bhd.（マレーシア）
- H) 嘉大精密化技股份有限公司（台湾）
- I) YAC GARTER CO., LTD KOREA BRANCH（韓国）



関係会社（海外）
関係会社（海外・孫会社）
関係会社海外支店

4 ワイエイシイグループの構成



国内

■ワイエイシイ(4事業部)

ワイエイシイ(株)	
メカトロニクス事業部	クリーニング事業部
ディスプレイ事業部	レーザシステム事業部

■グループ会社(6社)

(株)ワイエイシイデンコー	東京都青梅市
大倉電気(株)	埼玉県坂戸市
ワイエイエシイ新潟精機(株)	新潟県妙高市
(株)ワイエイシイダステック	埼玉県戸田市
YAC国際電熱(株)	東京都昭島市
ワイエイシイガーター(株)	東京都青梅市

海外

■グループ会社(3社)

YAC Systems Singapore Pte Ltd	シンガポール
瓦愛新(上海)国際貿易有限公司	中国上海市
台湾微艾新科技股份有限公司	台湾新竹市

■孫会社(5社)+支店(1)

紹興微愛新電子設備有限公司	中国紹興市
NIHON GARTER PHILIPPINES, INC.	フィリピン
蘇州嘉大電子有限公司	中国
NGC Garter(M)Sdn.Bhd.	マレーシア
嘉大精密科技股份有限公司	台湾
YAC GARTER CO.,LTD KOREA BRANCH	韓国支店

ワイエイシイ4事業部
グループ14社(国内6+海外3+海外孫会社5)

5-1 液晶・有機EL関連製品



プラズマドライエッチング装置

プラズマ技術を用いたドライエッチング装置。
LTPS・OLEDといったスマートフォン向けの高精細加工をはじめとして、製造プロセスの効率化や省マスク技術、大型化などに最適。

アニール装置

膜質の改質・改善をおこなうための熱処理装置、RTA装置。
LTPS高精細パネルの量産に適した装置で、スマートフォン・タブレットの更なる高性能化に寄与。

ウェットエッチング装置

薬液を用いたウェットエッチング装置。
IGZO・OLED・メタル配線といったスマートフォン向けの高精細加工をはじめとした中小型から大型基板に対応。



プラズマドライエッチング装置



アニール装置



ウェットエッチング装置

5-1 主な販売先



ワイエイシイ

主に自動機を製造・販売

主な販売先	主な製品
液晶パネルメーカー	プラズマエッチング装置 ウエットエッチング装置 熱処理装置
ハードディスクメーカー	バーニッシュ装置 UVキュア装置
半導体メーカー	テストハンドラー クリーンコンベア・ウェハ移載機 スライシング・ダイシングマシン レーザアニーラ キャリアテープ
太陽電池パネルメーカー	テクスチャリング装置 ISO・PSG装置
電力会社	工業計器製品 制御通信製品
自動車・航空機メーカー	加熱装置
クリーニング店	ワイシャツプレス機 ウール仕上機 自動包装機

5-2 主力製品の特長



製品	特長
HDDバーニッシュ装置	世界シェア100% HDDの高記録密度化の進展に伴い、継続的な需要あり
プラズマエッチング装置	スマートフォン、タブレット向けでは世界シェア№1
クリーニング店向け装置	ワイシャツ仕上機、包装機は国内シェア№1



HDDバーニッシュ装置



プラズマエッチング装置

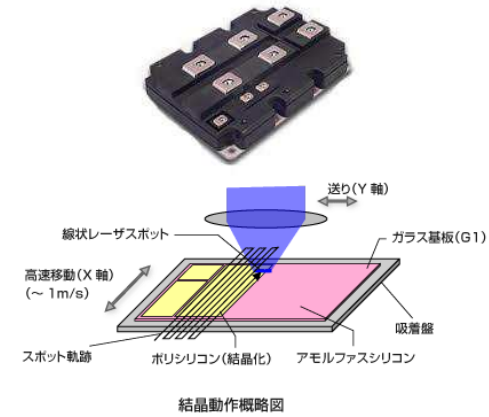
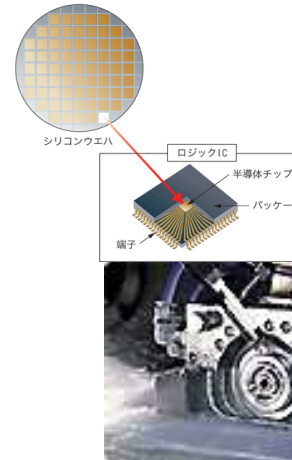


全自動包装機（立体タイプ）

5-3 コア技術



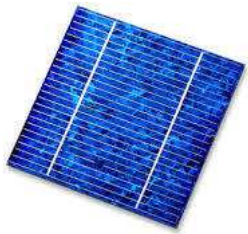
■半導体素子の構造



結晶動作概略図

— プラズマ・真空・熱 —
エッチング、改質、拡散

— 切断・レーザー —
ダイシング、拡散



— WET —
エッチング、テクスチャリング

— ハンドリング —
ハンドラー、コンベア

— 精密研磨 —
バーニッシュ

6-1 液晶・有機EL関連



プラズマドライエッチング装置

プラズマ技術を用いたドライエッチング装置。
LTPS・OLEDといったスマートフォン向けの高精細加工をはじめとして、製造プロセスの効率化や省マスク技術、大型化などに最適。

アニール装置

膜質の改質・改善をおこなうための熱処理装置、RTA装置。
LTPS高精細パネルの量産に適した装置で、スマートフォン・タブレットの更なる高性能化に寄与。

ウェットエッチング装置

薬液を用いたウェットエッチング装置。
IGZO・OLED・メタル配線といったスマートフォン向けの高精細加工をはじめとした中小型から大型基板に対応。



プラズマドライエッチング装置

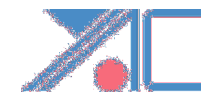


アニール装置



ウェットエッチング装置

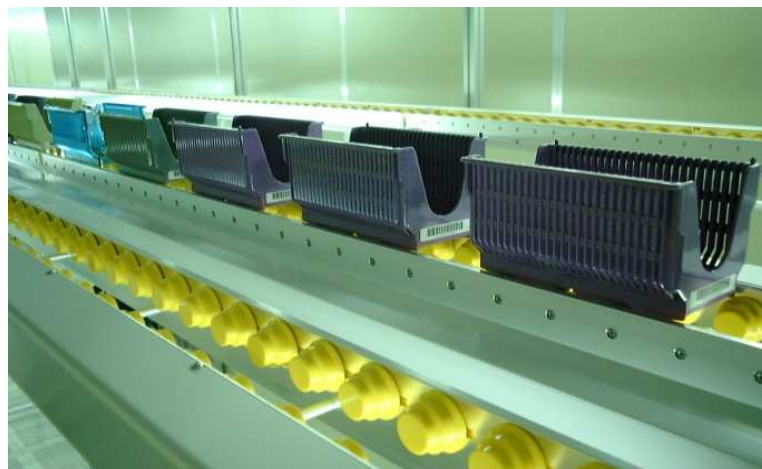
6-2 ハードディスク関連



HDD用バニッシャー装置	ディスクに磁性層形成後、表面のナノオーダーの微小突起を除去する精密研磨装置。
HDD用ワイピング装置	ディスクに磁性層形成後のバニッシュ工程の前後で、表面のパーティクル除去や潤滑剤を表面に均一にする装置。
HDD用UVキュア装置	ディスクの磁性膜面に塗布された潤滑剤を紫外線(UV)で硬化し潤滑層を形成する装置。
クリーンコンベア	HD工場向け： モジュールの組み合わせで自由な搬送ライン設計が可能 半導体工場向け： 300mm用ウエハポット用に高い耐加重性、耐衝撃性、搬送速度を達成 太陽電池工場向け： ガラス基板又は6“ウェーハが入ったカセットを高速搬送 液晶工場向け： 大型基板を高い耐加重性、耐衝撃性で搬送



バニッシャー



ハードディスク用クリーンコンベア



半導体用高速クリーンコンベア

6-3-1 半導体(検査工程、洗浄工程)



テストハンドラー	ロジック系等のIC用のパッケージング後の検査工程で良品と不良品に自動選別する装置。 低温～高温(-55℃～155℃)に対応。
半導体製造及び部品洗浄装置	・半導体向けウェット処理装置： 洗浄装置、レジスト剥離装置、ナイトライド装置 ・半導体向け周辺設備： 石英管洗浄装置、各種保管庫、薬液供給ユニット
IPAベーパー乾燥装置	半導体(LSI、MEMS、パワーデバイス)製造の洗浄工程の仕上の乾燥工程においてIPA(イソプロピルアルコール)蒸気を利用したパーティクル(異物)付着をゼロとした乾燥装置。



ロジック系ICテストハンドラー



石英管洗浄装置



IPAベーパー乾燥装置

6-3-2 半導体(レーザプロセス関連)



レーザアニーラ

- IGBT・パワー半導体素子用レーザアニーラ
 - ・裏面のみを2波長レーザアニールにより、アニール深さを1~10 μ mの範囲でコントロール。
 - ・連続発振レーザと、回転テーブルの組合せにより、高スループットを実現。
- SiC裏面電極金属層オーミック化専用装置
 - ・世界初のSiC裏面電極金属層オーミック化専用装置(開発~試作に対応)。
 - ・高い安定性・再現性・スループット・低ランニングコストで量産を支援。
- レーザスクライバ
 - ・SiC専用スクライバ デブリレスを実現

マイクロマルチレーザドリラ

- 超微細孔加工: 15~50 μ m径の超微細穴を加工。
- 多数穴超高速加工(高スループット):
最大100mm口内最大約100万個を30~500secで加工(最速0.1ms以下/穴)。
- 高精度加工: 穴位置精度 $<\pm 0.5\mu$ m、穴径精度 $<\pm 0.5\mu$ m。
- 長期安定・調整容易(少ダウンタイム):
レーザプロファイルの変動による影響を受けないシンプルな光学系により、調整が容易。



IGBT・パワー半導体素子用
レーザアニーラ



SiC裏面電極金属層
オーミック化専用装置



マイクロマルチレーザドリラ

6-3-3

半導体(精密切断関連)



<p>フルオートマテック スライサー</p>	<p>厚いデバイスや複合デバイスのような切りにくいデバイスを切断することを目的とするフルオートメーションのスライサーです。従来機では多段カット(ステップカット等)していたデバイスも、1パスでの切断を実現しました。 適用ワーク : サファイアデバイス、ガラス、セラミックを多く含む複合デバイス、CSP、QFP、QFN、そのほかのパッケージ、金属材料、セラミックス。</p>
<p>スライシング ダイシングマシン</p>	<p>自動θ軸・自動アライメント機能を有し、深切(厚物)をマルチブレードにて高精度に切断が可能です。コンパクトで安全性にも優れ、従来機との違いを実感いただける、「これからの切断機」です。</p>
<p>フルオートマテック コアドリルマシン</p>	<p>コアドリルマシンとは、円筒形磁石(コアドリル)にて丸形やドーナツ形状に切り抜くことが出来る装置です。ガラス・水晶などを丸型に切断加工できます。自動搬送・自動アライメント機能を搭載し、全自動化対応装置です。新規に小径ワーク(サイズ1φ~10φ)対応の超音波スピンドル搭載機DAR806をラインアップしました。</p>
<p>リセール事業</p>	<p>中古の切断装置、ダイサー、半導体製造装置の買い取り、再生・販売を行っています。</p> <div data-bbox="517 639 2179 1061"> <p>ダイサー再生・販売ステーションのしくみ (全て自社にてご提供)</p> </div>



DFS1100

フルオートマテックスライサー



DAS110

スライシング/ダイシングマシン



DAR806

自動コアドリルマシン

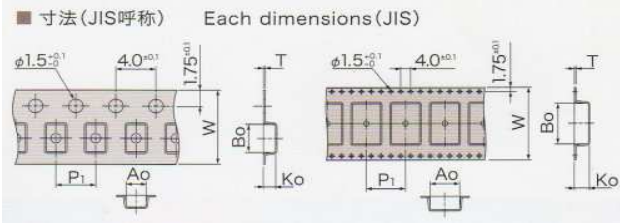
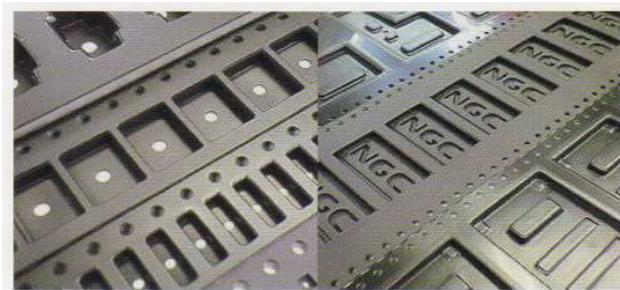


DAR810

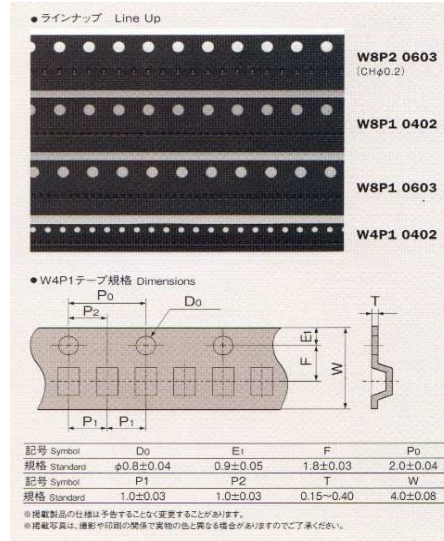
全自動コアドリルマシン

6-3-4 半導体(エンボスキャリアテープ関連)

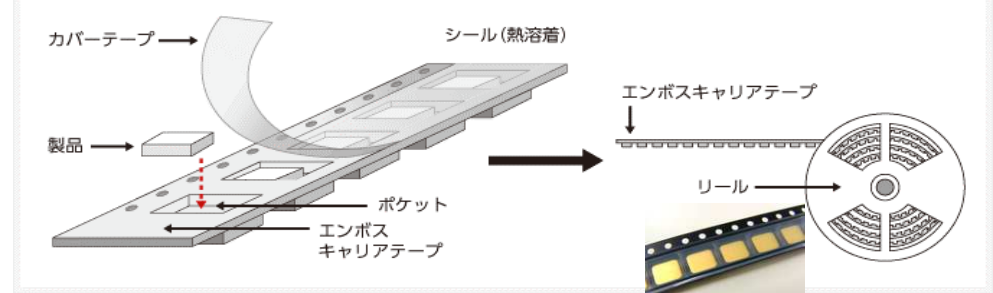
エンボスキャリアテープ	コンデンサ・ダイオード・トランジスタ・半導体・LEDなど様々な表面実装型(SMD)電子部品を自動実装機で実装するための梱包材料。
極小極薄エンボス	薄く(0.1mm以下)、小さな(0.2mm x 0.1mm)の製品を梱包するエンボスキャリアテープ。
テーピングサービス	試作段階や少量生産の電子部品をエンボスキャリアテープに挿入して真空梱包までを行うサービス。
ピーリングテスター	テーピング工程で、エンボスキャリアテープにカバーテープを熱シールした時の、剥離強度を適正に設定する試験機。
オートリールチェンジャー	テーピング工程で、リールに巻取った製品の自動交換によるテーピング機の連続稼働装置。設備稼働率を高め、オペレータの設備持ち台数を増やし、省力化に貢献する装置。



エンボスキャリアテープ



極小極薄エンボス



テーピングサービス



ピーリングテスター



オートリールチェンジャー

6-3-5 半導体(LED・電子部品関連)



LED分類機	ダイシング工程後のバルク状のLEDを、光学検査・電気特性検査を行い、最大256分類する装置。
テーピング機	分類後のバルク状のLED・電子部品を通電検査・方向整列し、エンボスキャリアテープに挿入、熱シール、梱包をする装置。
シートテーピング機	ダイシング工程後のシートに貼り付けられた半導体・LEDウェハをシートから剥がし、通電検査・光学検査・外観検査・方向整列し、エンボスキャリアテープに挿入、熱シール、梱包をする装置。
LED測定器	LED分類機、検査テーピング機に搭載し、LEDの光学測定、電気特性測定を行い、任意の分類結果を分類機、検査テーピング機へ通信する装置。
新市場LEDアライアンス	インド・ベトナムなどLED新市場に向けたLEDアライアンスを、LED用装置・部材の有力各社(キャノンマシナリー・武蔵エンジニアリング・TOWA・豊田合成・パナソニック・信越化学・兼松)と形成し、共同で新市場のLED製品の商品企画から製品の立上げ、教育を一貫して、サポート。



LED分類機



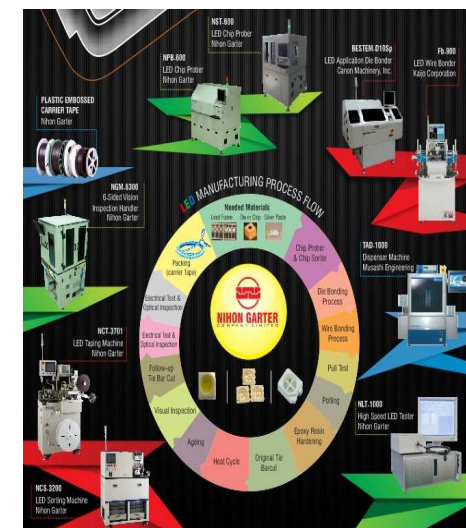
テーピング機



シートテーピング機



LED測定器



LEDアライアンス

6-4 太陽電池関連



結晶シリコン太陽電池製造用ウェット装置

テクスチャリング装置(バッチ式)
アイソレーション、PSGエッチング(バッチ式、インライン式)
配線形成装置

各種熱処理関連装置

縦型ガラス基板加熱装置
薄膜太陽電池EVA架橋炉
縦型多段式拡散炉
ウォーキングビーム式連続乾燥炉
チューブ式拡散炉



テクスチャリング装置



ISO/PSG装置



キュア/アニール炉

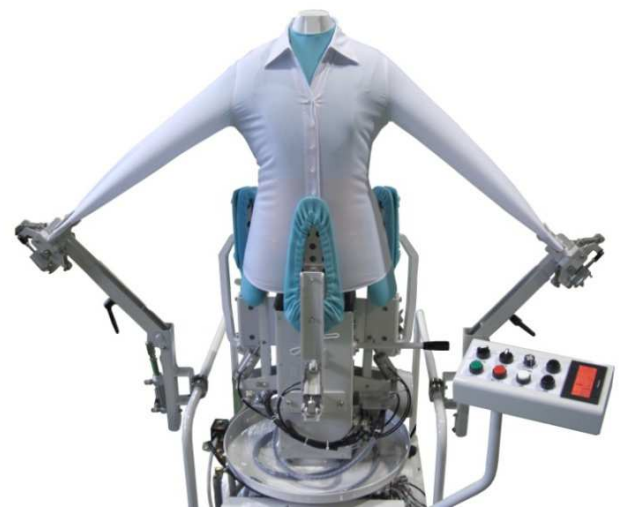
6-5 クリーニング関連



ワイシャツプレス機	ワイシャツの熱板、熱風によるプレス仕上装置： 襟とカフス、タックと袖、およびボディを3機種でプレス仕上。高速タイプはワイシャツプレス機の定番商品。ボディースリーブタイプは、タック、袖、ボディを1機種で仕上。
ウール仕上機	ウール製のジャケット、ブラウス、パンツ、スカートなどの仕上装置
自動包装機	クリーニング完了後の衣類の自動包装装置。 立体タイプ(ハンガーにかけたまま包装) 平面タイプ(畳んだ状態で包装)
アパレル関連機械	洋服の生産工程、縮絨機(生地を蒸気で安定化させる)、芯地・接着機(裁断後の生地を張り合わせる)、およびプレス仕上機(完成商品のシワを取り成型する)等、各種装置をラインナップ



ワイシャツ用ボディースリーブプレス機
(ダブルタイプ)



ジャケット・ブラウス仕上機



パンツ仕上機



全自動包装機 (立体タイプ)

6-6-1 精密熱処理(FPD、電子部品、自動車関連)

<p>フラットパネルディスプレイ(FPD)用加熱装置</p>	<p>液晶ディスプレイ製造用加熱装置： MB・MSシリーズ 液晶・OLEDディスプレイ製造用加熱装置： MTシリーズ 液晶ディスプレイ製造用ホットプレート式加熱装置 液晶・OLEDディスプレイ製造用減圧乾燥装置 液晶用ウォーキングビーム式連続焼成炉</p>
<p>電子部品加熱装置</p>	<p>メッシュベルト搬送式連続炉(マッフル) メッシュベルト搬送式連続炉(マッフルレス) ローラーハースキルン、電子部品用各種テスト炉</p>
<p>ヒーター及び関連機器</p>	<p>ラジアントパットヒーター(PD・GPD・MPDシリーズ) インフラユニ(BD・SD・FD・SGシリーズ) インフラユニットヒーター(PS・PU・PH・PMシリーズ)</p>
<p>自動車部品用加熱装置</p>	<p>自動車関連工業加熱装置(ハイテンション鋼板用) 金型加熱装置 金型予熱装置</p>



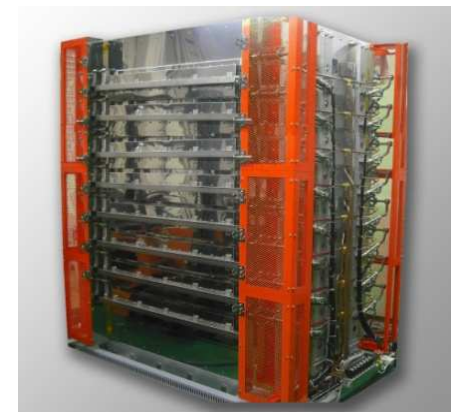
IGZO、OLEDアニール装置



メッシュベルト搬送式連続炉



多段式加熱炉
自動車関連ハイテンション鋼板

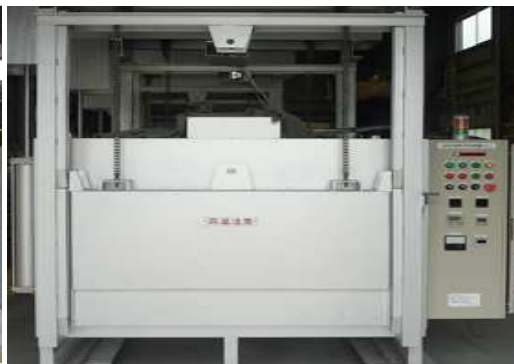


6-6-2 精密熱処理(金型加熱、工業炉関連)

<p>鑄造・鍛造用金型加熱装置</p>	<p>ダイヒータ DHシリーズ、 DC、LP、グラビティ、熱間鍛造、温間鍛造等の金型加熱装置</p>
<p>工業炉熱処理関連</p>	<p>台車炉、T5・T6熱処理炉、金型加熱炉、焼嵌め炉、ピット炉</p>
<p>航空機大型鍛造熱処理装置</p>	<p>高温金型予熱装置</p>
<p>高速昇温加熱装置</p>	<p>自動車パワートレーン工程用</p>



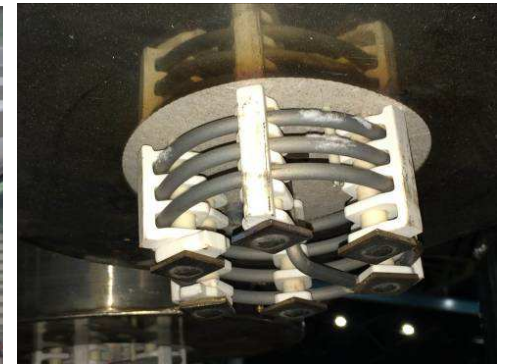
鑄造・鍛造用加熱装置



工業炉熱処理関連



航空機大型鍛造
熱処理装置



高速昇温加熱装置

6-7 工業計器・制御通信関連



工業計器

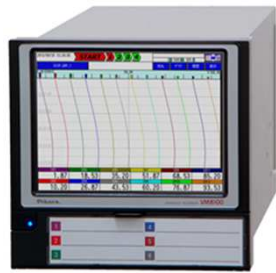
幅広い産業分野のオートメーション化に貢献。
計測と制御技術による原子力発電所採用の記録計・データロガー
精密温度制御による制御機器、水質・圧力・水位などのセンサー機器

制御通信

社会インフラの構築に貢献
大規模・広域ネットワークシステム(電力、上下水道、鉄道等)のネットワークシステムを支える情報伝送装置、
遠方監視制御装置、データ処理装置のシステム製品、高精度電力計測機器、および高信頼性モデムを提供。

半導体

縦型・横型拡散炉、拡散炉管理システムおよび他社製を含めた拡散炉のリニューアル対応機器を提供。工業計器メーカーとして培った計測・制御・センシングの固有技術を生かし、ユーザーニーズにきめ細かく対応。



ペーパーレスレコーダ



デジタル指示調節計
プログラム調節計



ハイブリッドレコーダ



圧力伝送器

工業計器製品



IP対応型情報伝送制御装置



IP対応型接点情報
入出力装置



高精度トランスデューサ

制御通信製品



縦型熱処理炉

半導体製品



さあ今日も、

ときめきと感動の日々であれ！

くまやか先端技術企業

ワイエイシー株式会社

数字の処理について

記載されている金額は百万円未満を切り捨て、その比率については小数 第2位を四捨五入しています。

業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予数値と異なる可能性があります。